財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：李怡秋
電話：03-5917759
傳真：03-5820466
E-mail：Lislee@itri.org.tw

109000828301

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 109. 05. 14 文
檔號： 109294

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 109 年 05 月 13 日
發文字號：工研轉字第 1090008283 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：本院擬舉辦「兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案」之公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案(專利 7 案 27 件)之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、本案之讓與標的第 6 案為共有專利(1 案 3 件)，係與國立臺灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱「台大醫院」）共有，除工研院讓與其應有部分外，台大醫院亦讓與其應有部分。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）109 年 6 月 11 日，開標日為 109 年 6 月 12 日。

（二）詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考工研院研發成果公告網站（https://itriwww.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036

461244216621372&MGID=1071676656424343135）

（三）公開說明會資訊：

1.舉辦時間：109 年 5 月 27 日 14 時。

2.舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

3.報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 5 月 26 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 5 月 26 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：（03）591-7759

傳真：（03）582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工業技術研究院
兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含兩相關節軟硬骨修復技術相關專利 7 案 27 件(以下簡稱「讓與標的」)。「讓與標的」相關資訊詳如附件讓與標的清單。

本讓與案中與國立臺灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱「台大醫院」）共有之 1 案 3 件共有專利（相關資訊詳如附件讓與標的清單之第 6 案），除工研院讓與其應有部分外，台大醫院亦讓與其應有部分。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）109 年 5 月 27 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 5 月 26 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 5 月 26 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 109 年 6 月 11 日 17 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表及商業營運計畫書一式 10 份

(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「兩相關節軟硬骨修復技術專利讓與案投標」，於截標日 109 年 6 月 11 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 李小姐 收

2. 本標案採「專利組合」方式投標，同一「專利組合」不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司簡介（10%）
2. 公司研發能力（40%）
3. 公司營運規劃（40%）
4. 其他(10%)(例如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃…等)

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 109 年 6 月 12 日(開標時間及地點請於開標日前一日洽詢「技轉法律中心」聯絡人)。
2. 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
3. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表、商業營運計畫書進行形式審查。

4. 投標廠商通過形式審查者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書進行審查評比，投標廠商應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔及書面文件。
5. 工研院開標審議委員會議將以商業營運計畫書總評比分數高低順序進行開標，以投標金額高於底價者得標。有二家（含）以上投標廠商總評比分數相同且投標金額均高於底價時，以總價高者得標；有二(含)以上投標廠商總評比分數相同、投標金額均高於底價，且總價相同者，由工研院現場抽籤決之。
6. 開標時將請律師到場監標。
7. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
8. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 60 個工作天內，與工研院及台大醫院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院及台大醫院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院及台大醫院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院及台大醫院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經各方均依法簽章且報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。「讓與標的」如為共有，亦須經「讓與標的」共有人同意後生效。
8. 得標廠商同意經濟部、台大醫院及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。

得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。

9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院及/或台大醫院已與第三人簽訂之授權契約(含專屬授權契約)；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若需將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，如依政府相關法令規定及「讓與契約書」之約定，應取得相關主管機關核准後始得為之者，得標廠商須於取得相關主管機關核准後，始得為之。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院及/或台大醫院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院及/或台大醫院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院及/或台大醫院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院及/或台大醫院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院及/或台大醫院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院及/或台大醫院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院及/或台大醫院無涉；工研院及/或台大醫院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院及/或台大醫院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院及/或台大醫院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用

行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、主管機關核准及同意後始得為之：

（1）得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

（2）得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（3）得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（4）得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13.得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得依政府相關法令（例如：「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」等）規定，將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有，並得終止或解除「讓與契約書」：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

經濟部依前項規定行使前項權利前，應將通知書或申請書送達得標廠商，限期三個月內答辯；逾期不答辯者，經濟部得逕行處理。

經濟部或工研院依第一項第(1)款將「讓與標的」授權他人實施時，被授權人應支付合理對價；得標廠商仍得實施「讓與標的」。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，如依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，應取得相關主管機關核准後始得為之者，得標廠商須取得相關主管機關核准後，始得為之；且因工研院依「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」規定及應主管機關要求，須陳報運用「讓與標的」所生之產業效益，故得標廠商並應依工研院之書面請求，將授權、讓與對象等相關資料通知工研院。

15.得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8.項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

17.得標廠商重整或聲請或被聲請重整;解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上(下稱：股權變動)時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於股權變動情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該股權變動情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 李小姐

電話：(03) 591-7759，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：Lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：讓與標的清單

案號	件號	件編號	專利中文名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	運用情形	共有狀態
1	1	134890004TW	製備多孔隙高分子材料的方法	TW	獲證	89116762	I232873	20050521	20200817	專屬授權中	
	2	134890004US	製備多孔隙高分子材料的方法	US	獲證	09/870,370	7,270,284	20020820	20210529	專屬授權中	
2	3	134900019CN	體外骨組織的培養方法及其多孔隙載體	CN	獲證	01144738.9	100532543	20090826	20211223	專屬授權中	
	4	134900019CND1	體外組織的培養方法及其多孔隙載體	CN	獲證	200910118097.5	101491703	20130220	20211223	專屬授權中	
	5	134900019TW	體外之組織培養方法	TW	獲證	90130491	I222997	20041101	20211209	專屬授權中	
	6	134900019USC1	體外之組織培養方法	US	獲證	11/808,117	7,767,445	20100803	20220808	專屬授權中	
3	7	134900027CN	多層次高分子材料的制備方法	CN	獲證	1145298	1429857	20040901	20211230	專屬授權中	
	8	134900027TW	製備多層次高分子材料的方法	TW	獲證	90131931	574273	20040201	20211220	專屬授權中	
	9	134900027US	製備多層次高分子材料的方法	US	獲證	10/241,440	6,824,716	20041130	20221020	專屬授權中	
4	10	P13910034TW	多層次組織培養方法及其載體	TW	獲證	91137060	I255852	20060601	20221222	專屬授權中	
	11	P13910034US	多層次組織培養方法及其載體	US	獲證	10/620,339	6,884,621	20050426	20230716	專屬授權中	
5	12	P13920026TW	組織切碎裝置	TW	獲證	92137613	I255738	20060601	20231230	專屬授權中	
	13	P13920026US	組織切碎機	US	獲證	10/879,863	7,270,284	20070918	20260216	專屬授權中	
6	14	P13940017TW	多層次移植載體，使用該載體之多層次組織修復之方法，以及使用該方法所製備之多層次植入材	TW	獲證	94147253	I316860	20091111	20251228	專屬授權中	與台大醫院共有
	15	P13940017USD1	多層次組織修復方法及其載體	US	獲證	12/385,775	8,183,041	20120522	20270408	專屬授權中	與台大醫院共有
	16	P13940017USD2	多層次組織修復方法及其載體	US	獲證	12/385,781	8,183,042	20120522	20270410	專屬授權中	與台大醫院共有

案號	件號	件編號	專利中文名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	運用情形	共有狀態
7	17	P56950008AU	細胞組織清洗裝置及方法	AU	獲證	2008202323	2008202323	20100527	20280526	專屬授權中	
	18	P56950008CA	細胞組織清洗裝置及方法	CA	獲證	2,632,304	2,632,304	20110913	20280525	專屬授權中	
	19	P56950008CNC1	細胞、組織或生物材料清洗裝置及方法	CN	獲證	200910126668.X	101544946	20150218	20290309	專屬授權中	
	20	P56950008DE	細胞組織清洗裝置及方法	DE	獲證	EP08157955.9	2014367	20120822	20280609	專屬授權中	
	21	P56950008ES	細胞組織清洗裝置及方法	ES	獲證	EP08157955.9	2014367	20120822	20280609	專屬授權中	
	22	P56950008FR	細胞組織清洗裝置及方法	FR	獲證	EP08157955.9	2014367	20120822	20280609	專屬授權中	
	23	P56950008GB	細胞組織清洗裝置及方法	GB	獲證	EP08157955.9	2014367	20120822	20280609	專屬授權中	
	24	P56950008IT	細胞組織清洗裝置及方法	IT	獲證	EP08157955.9	2014367	20120822	20280609	專屬授權中	
	25	P56950008JP	細胞組織清洗裝置及方法	JP	獲證	2008-168938	5049898	20120727	20280626	專屬授權中	
	26	P56950008TWC1	細胞、組織或生物材料清洗裝置及方法	TW	獲證	97123478	I385031	20130211	20280623	專屬授權中	
	27	P56950008USC1	細胞、組織或生物材料清洗裝置及方法	US	獲證	12/104,685	8,623,641	20140107	20320723	專屬授權中	

*本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。